

## CuNi（銅－ニッケル）系抵抗ペースト

シリーズ	型番	シート抵抗	抵抗温度係数*1		粘度	焼成膜厚*2	塗布面積	推奨焼成条件
Series	Type	Sheet resistance mΩ/□ @20μmt	HTCR ppm/°C	CTCR ppm/°C	Viscosity Pa·s	Fired Thickness μmt	Coverage cm <sup>2</sup> /g	Sintering schedule
DH	CN01DH	10	500±50	520±50	30~50	18~20	55	900 °C 10min In N <sub>2</sub>
	CN03DH	30	-100±50	-90±50	30~50	18~20	55	900 °C 10min In N <sub>2</sub>
D	CNR10D	100	-90±50	-60±50	30~50	20~25	68	900 °C 10min In N <sub>2</sub>
	CNR50D	500	-70±50	-40±50	30~50	20~25	76	900 °C 10min In N <sub>2</sub>
	CN1R5D	1,500	-50±50	-20±50	30~50	20~25	80	900 °C 10min In N <sub>2</sub>
	CN3R0D	3,000	-20±50	20±50	30~50	20~25	82	900 °C 10min In N <sub>2</sub>

対応基板：Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, 対応電極：Cu, 塗布方法：スクリーン印刷, 保管条件：冷蔵

Substrate : Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Electrode : Cu, Coating method : Screen printing, Storage condition : Refrigeration

\* 1 HTCRは25 °C~ 155 °C, CTCRは-55 °C~ 25 °Cで評価

Hot temperature coefficient of resistance (HTCR) between 25 °C and 155 °C, cold temperature coefficient of resistance(CTCR) between -55 °C and 25 °C

\* 2 標準スクリーン版使用時 メッシュ：#250-φ30μm, カレンダー加工, 乳剤厚：30μm

When using the standard screen printing plate Mesh : #250-φ30μm, Calendering, Thickness of emulsion : 30μm